证券代码：601026　　证券简称：道生天合　　公告编号：2026-043

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 20 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司拟投资建设高性能电子树脂项目并签署<投资协议书>的议案》

经审议，董事会认为本次对外投资有利于进一步完善产业布局、增强电子材料领域的技术储备与市场响应能力，符合公司长期发展战略，项目资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意公司在浙江省衢州智造新城投资建设年产 8,000 吨高性能电子树脂（包括碳氢树脂、聚苯醚树脂、双马树脂和低介质损耗含磷阻燃树脂等）项目，并与衢州智造新城管理委员会签署《投资协议书》，项目计划总投资约人民币 4.5

亿元，其中固定资产投资约 3.2 亿元，项目实施主体为公司全资子公司道生电子材料科技（浙江）有限公司。

同时，董事会同意授权公司管理层全权处理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理审批及备案手续等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日